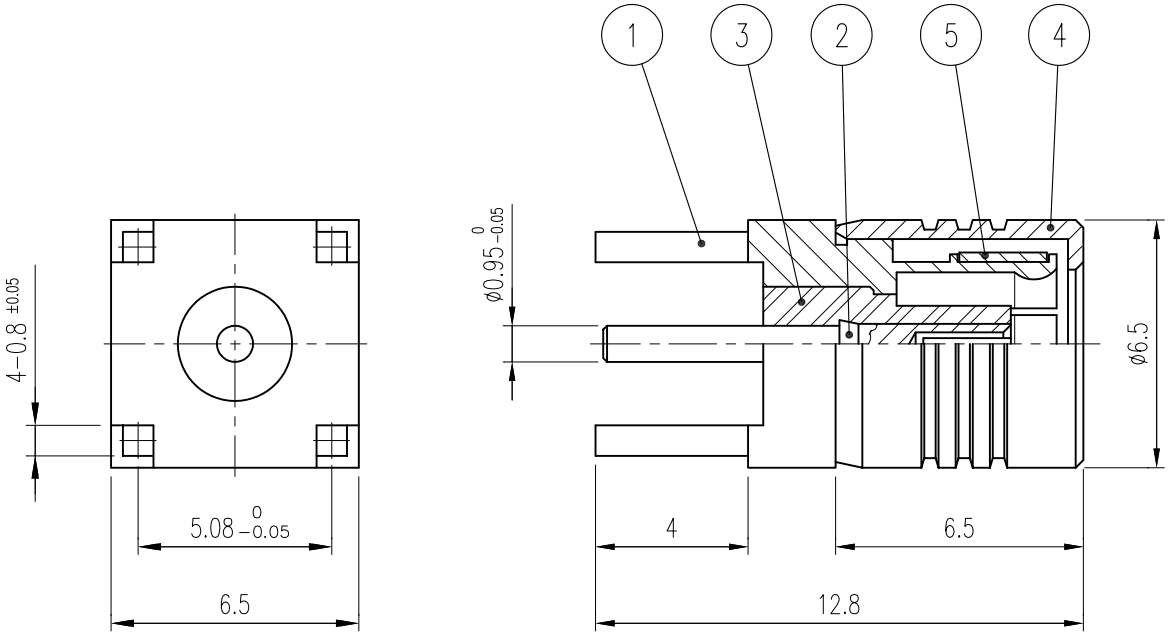
가공 / ST										
ST(기존)										
ST(개선)										

수 정 내 용				
부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일



품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
5	SPRING RING	1	BeCu	Gold Plate	DSR00004-5/1 (R3001)
4	CAP	1	MBsBD	Gold Plate	DCU00021-5/1 (K3001)
3	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00334-N/1 (H3026)
2	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT00371-5/1 (E3018)
1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD00493-5/1 (D3023)

대체가능재질

공통공차
.* ±0.1
.** ±0.05

재질 _____

열처리 _____

보호피막처리 _____

년월일 1999. 5. 21.

승인

검도

제도

작성부서 연 구 소

척도 8/1 단위 mm 중량 ___

KJ COMTECH

KJ COMTECH CO.,LTD.

RF & MICROWAVE TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

도명 SMB-P-4R-R

A4

도번 CN00945-7/2

K315-427-000